

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（<u>投资者开放日</u>）</div>
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2026 年 1 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1. 公司整体发展经营情况介绍？</div> <div>甬矽电子成立于 2017 年 11 月，从成立之初就聚焦集成电路中高端及先进晶圆级封装测试服务，终端包含消费类电子、物联网、工业/汽车电子及 AI 高性能计算领域等。公司总部位于浙江省宁波市余姚市，在上海、深圳、中国台湾等地设销售办公室，目前拥有两个生产基地，一期占地 126 亩，产品包括 SiP 系统级封装、WB-BGA、Sensor 等产品；二期占地 300 亩，预计总投资 110 亿，聚焦晶圆级封装等先进封装产品；未来拟于马来西亚建设海外基地以更好服务海外大客户。公司从 2018 年 6 月实现量产，当年实现营业收入超过 3000 万；2019 年全年出货量超过 9 亿颗并通过车规认证。2022 年于科创板上市；2023 年二期工厂启动；2024 年营收增长率超过 50%。从公司成立至今，出货量及营业收入一直保持增长状态。2019 年至 2021 年，随着公司高端封装产品系统级</div>

	<p>封装产品（SiP）收入规模及占比、毛利率的提高，QFN等产品销售单价及毛利率的提高，公司毛利率及净利润逐年增长。2022年至2023年，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重因素影响，以消费电子为代表的终端市场整体需求疲软，半导体行业需求出现较大波动，整体出现周期性下行。下游客户处于去库存阶段，并且2023年二期工厂启动，相应固定资产折旧进入财务报表中，导致该阶段毛利率处于较低水平。2023年后迎来行业周期拐点，随着全球终端消费市场出现回暖，产业链去库存周期基本结束，叠加AI应用场景不断涌现，集成电路行业整体景气度回升明显在公司层面，得益于海外大客户突破并且在2025年持续放量，以及原有核心客户群高速成长，规模效应逐渐体现，整体毛利率回升。</p> <p>2. 产品价格变动趋势？</p> <p>一方面，上游原材料价格与下游需求持续向好，产品价格可能因此水涨船高；另一方面在产能饱和情况下客户可能会出于缩短交期目的而主动溢价。</p> <p>3. 公司毛利率相对于同行业水平较高的主要原因？</p> <p>产品及客户方面，公司聚焦于“有门槛的客户”与“有门槛的产品”，下游客户以品牌终端为主，粘性强，导入周期长但合作关系稳定；同时，公司持续提升工程研发能力，努力成为多家客户一供并深度参与其新产品开发，可以获取更高价值的新产品订单；运营效率方面，工厂自动化水平高、人机比优、设备利用率高，构成隐形成本优势。</p> <p>4. 2026年稼动率水平及订单预期？</p> <p>稼动率方面，目前一季度公司整体稼动率将维持在较高水平；订单方面，中国台湾地区头部封测企业因产</p>
--	--

	<p>能紧张，将消费类封装产能转向至 AI/HPC 等产品，导致消费类电子订单外溢，总体上公司对于 2026 年的订单预期较为乐观。</p> <p>5. 2026 年 Q1 营业收入预期？</p> <p>2026 年 Q1 的客户需求 Forecast 相对较为旺盛，整体呈现淡季不淡的特点。</p> <p>6. 2026 年全年营业收入展望？</p> <p>根据公司发布的 2025 年年度业绩预告，预计 2025 年年度实现营业收入 420,000 万元至 460,000 万元，与上年同期相比，同比增加 16.37%至 27.45%，对 2026 年营业收入增速持乐观态度。</p> <p>7. 2.5D 先进封装产线进展情况？</p> <p>公司 2.5D 封装产线于 2024 年四季度通线，目前正在和相关客户做产品验证。但由于 2.5D 封装产品工艺复杂，验证周期较长，实现稳定量产需要一定时间。产能方面，公司后续会根据国产先进制程产能释放节奏进行扩产。</p> <p>8. 2026 年预计资本开支情况？</p> <p>2026 年资本开支规模预计较 2025 年有所增长，主要投向包括现有产品线产能扩张、新客户产品导入、晶圆级封装及 2.5D、FC 类产品等领域。</p> <p>9. 产品下游应用领域结构情况？</p> <p>AIoT 营收占比接近 70%，目前 AIoT 领域处于“创新驱动”周期，AI 驱动下新应用场景渗透率提升，下游需求预计将会持续增长；PA 营收占比约为 10%，后续重心以 PAMiF 及 PAMiD 模组类产品为主；安防营收占比约为 10%，整体增速平稳；运算和车规产品营收合计占比 10%左右，未来随着国内车规设计公司的发展以及海外车规大厂本土化布局战略的推进和 AI 发展对运算类芯片的</p>
--	---

	<p>需求，预计运算和车规领域的增速较快，营收占比将会持续提升。</p> <p>10. 2026 年预计折旧情况？</p> <p>2026 年全年折旧的绝对金额预计相比 2025 年仍会上涨。未来随着原有投资设备折旧期陆续到期，折旧压力缓解，利润空间有望逐步释放，对整体盈利能力产生积极影响。</p> <p>11. 海外客户拓展情况？</p> <p>目前海外有两家中国台湾地区头部设计公司已经进入公司前五大客户，并积极拓展包含欧美地区在内的其他海外头部设计企业。整体而言，随着公司营收规模不断扩大和服务能力的持续提升，公司与现有海外客户的合作将进一步深化，并将持续在新的海外客户取得突破，公司预期未来海外客户营收占比会进一步提升。</p> <p>12. 海外工厂进展情况？</p> <p>新加坡子公司和马来西亚子公司已成立，目前海外工厂建设工作正在稳步推进中，主要服务于海外大客户。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 1 月 19 日

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。